



boschman
advanced packaging technology

UNISTAR 系列

薄膜辅助塑封技术



Boschman 是提供高度创新封装解决方案的一站式服务提供商。

Boschman 是一家以解决方案为导向的荷兰高科技公司，专注于提供先进的封装解决方案。我们秉持独特的一站式服务理念，从构想到工业化，针对所有封装业务为客户提供一站式接洽点。这种方式可确保所有工艺得到仔细监控和集成，从而创造最有效且高效的封装解决方案，帮助客户尽可能缩短产品上市时间。

我们的行业应用重点

我们正在为以下行业的客户提供优质服务：

- 汽车
- 医疗
- 航空航天
- 移动
- 工业 & 可再生能源

我们的应用领域



微机电系统和传感器



2.5D/3D 封装



高功率模块和封装



智能卡



光学封装



我们的产品

关于薄膜辅助塑封技术

薄膜辅助塑封包含一系列专有技术，是传递模塑封工艺的一种变化形式。薄膜辅助塑封工艺需要在模具中放置一张或两张塑料薄膜。在将引线框架或基板（即待封装的产品）装入模具之前，该薄膜会被吸附到模具的内表面（剔料池、流道和模腔）。接下来便是常规的传递模塑封工艺。

Boschman 提供两种薄膜辅助塑封解决方案：对于研发、原型制作和小批量生产，我们提供半自动 Unistar Innovate 系列。而对于高效、高质量的大中批量生产，Unistar Auto 系列是最佳选择。



Unistar Innovate-2-FF-L

这是最通用的半自动塑封系统，适用于几乎任何类型的封装，适用于引线框架、基板和陶瓷载体以及单个模块。可处理标准迷你芯块、粉末和液体封装材料。



Unistar Innovate-2-NF-L

这是最通用的半自动模塑系统，适用于传统封装。适合中小批量生产。从一种封装转移到另一种低成本加工所需的转换时间非常短。



我们的产品

Innovate 的主要特性:

- 最大引线框架/面板尺寸 255 x 75 mm
- 单模，适用于单带或双带
- 夹紧力高达 100 吨
- 集成切料工具
- 无、单或双薄膜
- 采用动态压头技术，可创建具有暴露区域的封装/芯片
上有开放区域的封装
- 适用于引线框架、基板和陶瓷载体以及单个模块
- 多功能系统，方便在不同封装之间快速轻松地转换
- 使封装产品轻松脱模。
- 模具的金属表面保持洁净
- 使用多种塑封材料，包括强粘型和液体硅胶材料



Unistar Auto-2-FF-L

全自动 2 带薄膜辅助塑封系统，专为先进的微机电系统、传感器、电源、方形扁平无引线 (QFN) 器件和球栅阵列 (BGA) 封装而设计。该系统适用于引线框架、基板和陶瓷载体以及单个模块。



Unistar Auto-4-FF-XL

全自动 4 带薄膜辅助塑封系统，专为先进的微机电系统、传感器、电源、方形扁平无引线 (QFN) 器件和球栅阵列 (BGA) 封装而设计。该系统适用于引线框架、基板和陶瓷载体以及尺寸达 100 x 300 mm 的单个模块。



我们的产品

Auto 的主要特性:

- Sinterstar Innovate 系列的所有规格和价值:
- 最大引线框架/面板尺寸 300 x 100 mm
- 单模或双模 (双带或 4 带)
- 夹紧力高达 200 吨
- 集成晶片盒处理器
- 具有大量系统选项, 能够提高生产效率、增强工艺控制并保证最佳质量
- 适用于光学器件的 100 级洁净室选项
- 工具使用寿命极长, 因而运行成本非常低
- 采用 Secs-Gem 通信程序包, 能够与客户的 MES 系统、产品可追溯系统和配方管理系统对接
- 提供许多标准选项, 能够实现快速换型、提高生产率并保证质量

“尺寸更小、性能更好、成本更低，
为您的产品提供最好的封装！”



package
development



assembly
services



equipment

Boschman | 先进封装技术

Stenograaf 3 6921 EX Duiven 电话 +31 26 319 4900 电子邮箱 info@boschman.nl

www.boschman.nl